

<<牙体牙髓病学>>

图书基本信息

书名：<<牙体牙髓病学>>

13位ISBN编号：9787117158503

10位ISBN编号：7117158506

出版时间：2012-7

出版时间：樊明文 人民卫生出版社 (2012-07出版)

作者：樊明文 编

页数：437

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<牙体牙髓病学>>

内容概要

牙体牙髓病学是研究牙体硬组织和牙髓组织疾病的发病机制、病理变化、病理生理、临床表现、治疗及转归的一门学科。

《卫生部“十二五”规划教材：牙体牙髓病学（第4版）》内容包括龋病学、牙体硬组织非龋性疾病和牙髓病学三个大的篇章，涉及这些疾病的病因、临床病理、症状、诊断、治疗和预防各个方面。

<<牙体牙髓病学>>

书籍目录

绪论 第一篇 龋病 第一章 概述 第一节 龋病的概念 一、龋病的定义和特征 二、龋病的历史 三、龋病学的研究内容 第二节 龋病流行病学 一、评价方法 二、龋病的好发部位 三、现代人龋病流行情况 四、龋病流行趋势 第二章 病因及发病过程 第一节 牙菌斑 一、牙菌斑的结构 二、牙菌斑的组成 三、牙菌斑的形成和发育 四、牙菌斑微生物学 五、牙菌斑的物质代谢 六、牙菌斑的致龋性 第二节 饮食因素 一、碳水化合物 二、蛋白质 三、脂类 四、维生素 五、无机盐 第三节 宿主 一、牙 二、唾液 三、免疫 第四节 影响龋病发生和发展的其他因素 一、年龄 二、性别 三、种族 四、家族与遗传 五、地理因素 第五节 病因学说 一、内源性理论 二、外源性学说 三、蛋白溶解学说 四、蛋白溶解 - 螯合学说 五、Miller 化学细菌学说 六、龋病病因四联因素理论 七、广义龋病生态学假说 第三章 临床表现与诊断 第一节 龋病的病理过程 一、釉质龋 二、牙本质龋 三、牙骨质龋 四、脱矿和再矿化 第二节 龋病的临床表现及分类 一、按发病情况和进展速度分类 二、按损害的解剖部位分类 三、按病变深度分类 第三节 龋病的诊断 一、诊断方法 二、诊断标准 第四章 龋病治疗 第一节 非手术治疗 一、药物治疗 二、再矿化治疗 三、预防性树脂充填术 第二节 牙体修复治疗的生物学基础 一、釉质 二、牙髓牙本质复合体 三、牙骨质 四、牙周组织 第三节 牙体修复与材料选择的原则 一、牙体修复的原则 二、充填材料选择的原则 第四节 窝洞的分类与结构 一、窝洞的分类 二、窝洞的命名 三、窝洞的结构 第五节 深龋的治疗 一、深龋的治疗原则 二、深龋的治疗方法 三、深龋的治疗方案 第六节 根面龋的治疗 一、根面龋的临床特点 二、根面龋的治疗原则 第五章 银汞合金充填 第一节 窝洞预备的基本原则 一、去净龋坏组织 二、保护牙髓组织 三、尽量保留健康牙体组织 四、注意患者全身状况 第二节 窝洞预备的基本步骤 一、预备洞形 二、无痛制洞法 三、术区隔离 四、窝洞消毒 五、窝洞封闭、衬洞及垫底 第三节 银汞合金充填术 一、适应证 二、窝洞预备的要求 三、各类银汞合金充填窝洞的预备要点 四、银汞合金的调制 五、银汞合金充填 六、汞污染及预防 第四节 龋病治疗并发症及处理 一、意外穿髓 二、充填后疼痛 三、充填体折断、脱落 四、牙齿折裂 五、继发龋 第六章 牙体缺损的粘结修复 第一节 牙体粘结技术原理 一、概述 二、釉质粘结 三、牙本质粘结 第二节 牙色修复材料 一、复合树脂 二、玻璃离子体 三、复合体 第三节 复合树脂直接修复术 一、概述 二、准备过程 三、牙体预备与牙髓保护 四、成形片的放置 五、粘结 六、复合树脂的充填 七、复合树脂的固化 八、修复体的修形和抛光 第四节 前牙复合树脂直接修复 一、概述 二、类洞直接修复的临床技术 三、类洞直接修复的临床技术 四、类洞直接修复的临床技术 第五节 后牙复合树脂直接修复 一、概述 二、类洞直接修复的临床技术 三、类洞直接修复的临床技术 四、类洞玻璃离子体加复合树脂三明治修复技术 五、后牙直接修复失败的原因 绪论 第一篇 龋病 第一章 概述 第一节 龋病的概念 一、龋病的定义和特征 二、龋病的历史 三、龋病学的研究内容 第二节 龋病流行病学 一、评价方法 二、龋病的好发部位 三、现代人龋病流行情况 四、龋病流行趋势 第二章 病因及发病过程 第一节 牙菌斑 一、牙菌斑的结构 二、牙菌斑的组成 三、牙菌斑的形成和发育 四、牙菌斑微生物学 五、牙菌斑的物质代谢 六、牙菌斑的致龋性 第二节 饮食因素 一、碳水化合物 二、蛋白质 三、脂类 四、维生素 五、无机盐 第三节 宿主 一、牙 二、唾液 三、免疫 第四节 影响龋病发生和发展的其他因素 一、年龄 二、性别 三、种族 四、家族与遗传 五、地理因素 第五节 病因学说 一、内源性理论 二、外源性学说 三、蛋白溶解学说 四、蛋白溶解 - 螯合学说 五、Miller 化学细菌学说 六、龋病病因四联因素理论 七、广义龋病生态学假说 第三章 临床表现与诊断 第一节 龋病的病理过程 一、釉质龋 二、牙本质龋 三、牙骨质龋 四、脱矿和再矿化 第二节 龋病的临床表现及分类 一、按发病情况和进展速度分类 二、按损害的解剖部位分类 三、按病变深度分类 第三节 龋病的诊断 一、诊断方法 二、诊断标准 第四章 龋病治疗 第一节 非手术治疗 一、药物治疗 二、再矿化治疗 三、预防性树脂充填术 第二节 牙体修复治疗的生物学基础 一、釉质 二、牙髓牙本质复合体 三、牙骨质 四、牙周组织 第三节 牙体修复与材料选择的原则 一、牙体修复的原则 二、充填材料选择的原则 第四节 窝洞的分类与结构 一、窝洞的分类 二、窝洞的命名 三、窝洞的结构 第五节 深龋的治疗 一、深龋的治疗原则 二、深龋的治疗方法 三、深龋的治疗方案 第六节 根面龋的治疗 一、根面龋的临床特点 二、根面龋的治疗原则 第五章 银汞合金充填 第一节 窝洞预备的基本原则 一、去净龋坏组织 二、保护牙髓组织 三、尽量保留健康牙体组织 四、注意患者全身状况 第二节 窝洞预备的基本步骤 一、预备洞形 二、无痛制洞法 三、术区隔离 四、窝洞消毒 五、窝洞封闭、衬洞及垫底 第三节 银汞合金充填术 一、适应证

<<牙体牙髓病学>>

二、窝洞预备的要求 三、各类银汞合金充填窝洞的预备要点 四、银汞合金的调制 五、银汞合金充填
六、汞污染及预防 第四节 龋病治疗并发症及处理 一、意外穿髓 二、充填后疼痛 三、充填体折断、脱落
四、牙齿折裂 五、继发龋 第六章 牙体缺损的粘结修复 第一节 牙体粘结技术原理 一、概述 二、釉
质粘结 三、牙本质粘结 第二节 牙色修复材料 一、复合树脂 二、玻璃离子体 三、复合体 第三节 复合
树脂直接修复术 一、概述 二、准备过程 三、牙体预备与牙髓保护 四、成形片的放置 五、粘结 六、复
合树脂的充填 七、复合树脂的固化 八、修复体的修形和抛光 第四节 前牙复合树脂直接修复 一、概述
二、 类洞直接修复的临床技术 三、 类洞直接修复的临床技术 四、 类洞直接修复的临床技术 第
五节 后牙复合树脂直接修复 一、概述 二、 类洞直接修复的临床技术 三、 类洞直接修复的临床技
术 四、 类洞玻璃离子体加复合树脂三明治修复技术 五、后牙直接修复失败的原因 第二篇 牙体
硬组织非龋性疾病 第三篇 牙髓病和根尖周病

<<牙体牙髓病学>>

章节摘录

版权页：插图：缺损少，牙本质未暴露的冠折，可将锐缘磨光。

牙本质已暴露，并有轻度敏感者，可行脱敏治疗。

敏感较重者，用临时塑料冠，内衬氧化锌丁香油糊剂粘固，待有足够修复性牙本质形成后（6~8周），再用复合树脂修复牙冠形态，接近牙髓腔时须用氢氧化钙制剂垫底，以免对牙髓产生刺激。

牙髓已暴露的前牙，对牙根发育完成者应用牙髓摘除术；对年轻恒牙应根据牙髓暴露多少和污染程度作活髓切断术，以利于牙根的继续发育，当根端发育完成后，有人主张还应行根管治疗术，因为钙化过程将持续进行并堵塞根管，而在以后作桩核冠修复需要作根管治疗时，却难以进行根管预备和桩的置入，导致难以完成桩核冠修复。

牙冠的缺损，可用复合树脂或烤瓷冠修复。

应该特别指出，凡仍有活力的牙髓，应在治疗后1、3、6个月及以后几年中，每半年复查1次，以判明牙髓的活力状况。

牙的永久性修复都应在受伤后6~8周进行。

根折的治疗首先应是促进其自然愈合，即使牙似乎很稳固，也应尽早用夹板固定，以防活动。

除非牙外伤后已数周才就诊，而松动度又较小就不必固定。

一般认为根折越靠近根尖其预后越好。

当根折限于牙槽内时，对预后是很有利的，但折裂累及龈沟或发生龈下折时，常使治疗复杂而且预后亦差。

对根尖1/3折断，在许多情况下只上夹板固定，无需牙髓治疗，有可能出现修复并维持牙髓活力，那种认为根折牙应进行预防性牙髓治疗的观点是不正确的。

因为根折后立即进行根管治疗常常有可能把根管糊剂压入断端之间，反而影响其修复。

但当牙髓有坏死时，则应迅速进行根管治疗术。

对根中1/3折断可用夹板固定，如牙冠端有错位时，在固定前应复位。

复位固定后，每月应复查1次，检查夹板是否松脱，必要时可更换夹板。

复查时，若牙髓有炎症或坏死趋势，则应作根管治疗术。

根管不用牙胶尖充填而用玻璃离子粘固剂将钛合金或钴铬合金桩粘固于根管中，将断端固定在一起，以利根面的牙骨质沉积。

当因治疗需要将根尖部断块用手术方法去除后，因冠侧段过短而支持不足时，常需插入钛合金根管骨内种植体以恢复牙原来的长度，同时牙冠部用夹板固定。

这样骨组织会在金属“根”周围生长而将病理动度消除。

<<牙体牙髓病学>>

编辑推荐

<<牙体牙髓病学>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>